中國信託證券投顧
CTBC SECURITIES INVESTMENT SERVICE

台積電 2026 年第三季法說會
先進製程擴產加速，高含積量 ETF 一次看

2026/10/20

大 綱

一. 台積電法說：獲利創高、展望上修

二. 先進製程擴產，迎AI超級週期

三. 台灣掛牌之高含積量ETF一覽

一、台積電法說：獲利創高、展望上修

3Q26 財報亮點：營收、獲利同創單季新高

- 3Q26 營收 467.2 億美元（季增 16.2%），優於財測上緣 458 億美元；EPS 29.43 元，年增 68.7%，連續第 11 季獲利成長。
- 毛利率 66.4% 落在財測區間，較上季下滑 1.3 個百分點，主因 2 奈米（N2）量產初期稀釋；營益率 58.7% 優於財測上緣。

營收（新台幣）	稅後淨利	每股盈餘 EPS	股東權益報酬率
14,942億	7,631億	29.43 元	45.5%
↑ 年增 50.9%	↑ 年增 68.7%	↑ 優於共識 28.38 元	↑ 年增 7.7 個百分點

美元營收	毛利率	營業利益率	自由現金流
467.2億	66.4%	58.7%	4,766億
財測 446–458 億美元	財測 65.0%–67.0%	財測 56.0%–58.0%	↑ 季增 1,892 億元

- 晶圓出貨 447.6 萬片（12吋約當），季增 3.2%；7 奈米以下先進製程占晶圓營收 79%，HPC 占營收 68%。
- 董事會核准第二季現金股利每股 7.0 元，12/10 除息，2027/1/7 發放。

資料來源：台積電 3Q26 法人說明會資料、Management Report、Bloomberg，2026/10/15。

財報 vs. 彭博市場共識：營收、獲利全面優於預期

- 營收、EPS、淨利分別優於彭博共識 2.1%、3.7%、3.2%；毛利率 66.40% 僅略低於共識 0.08 個百分點，屬 N2 爬坡的已知逆風。
- 前三季資本支出 406 億美元，3Q 支出 4,432 億元低於共識 5,063 億元，隱含 4Q 支出將跳升至 194–234 億美元。

台積電 3Q26 實際值 vs. 公司財測 vs. 彭博共識

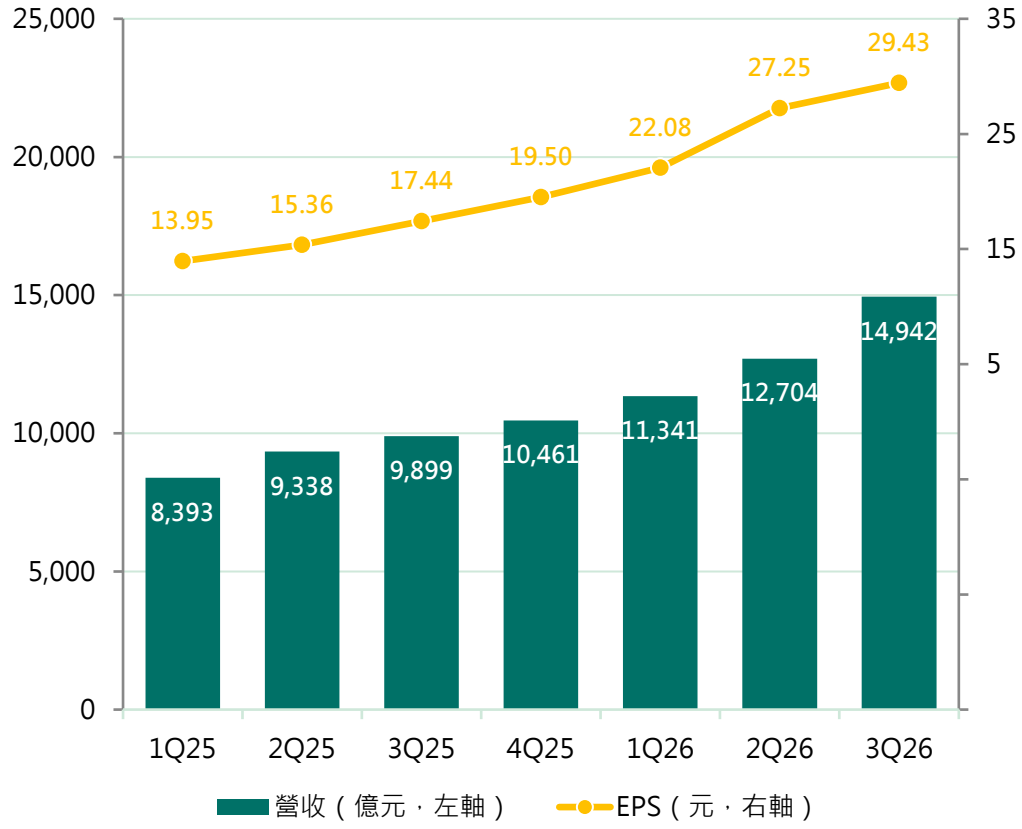
指標	3Q26 實際	公司財測	彭博共識	差異
營收（新台幣）	14,942 億	—	14,633 億	+2.1%
營收（美元）	467.2 億	446–458 億	—	優於上緣
EPS（元）	29.43	—	28.38	+3.7%
稅後淨利	7,631 億	—	7,395 億	+3.2%
毛利率	66.40%	65.0%–67.0%	66.48%	-0.08 ppt
營業利益率	58.65%	56.0%–58.0%	58.10%	+0.55 ppt
資本支出	4,432 億	—	5,063 億	低於預期

資料來源：Bloomberg Consensus Data、台積電，2026/10/15。

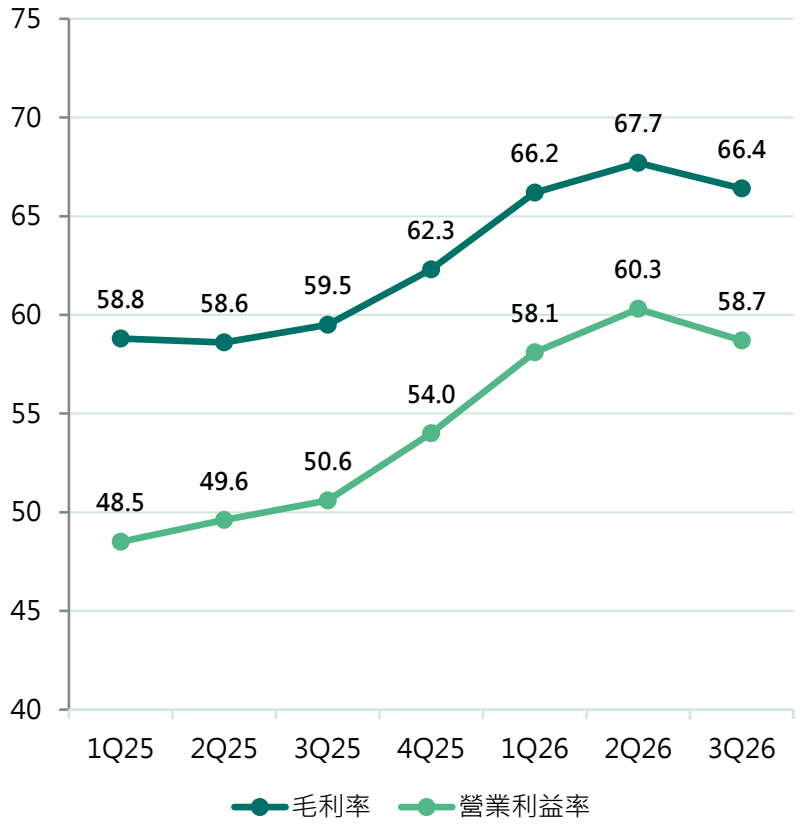
營收、EPS 逐季攀升，毛利率站穩 66% 以上

- 營收由 1Q25 的 8,393 億元成長至 3Q26 的 1兆4,942 億元，六季增幅 78%；同期毛利率擴張約 760 個基點至 66.4%，反映先進製程組合與定價能力。

季營收（億元）與 EPS（元）



毛利率 / 營業利益率（%）

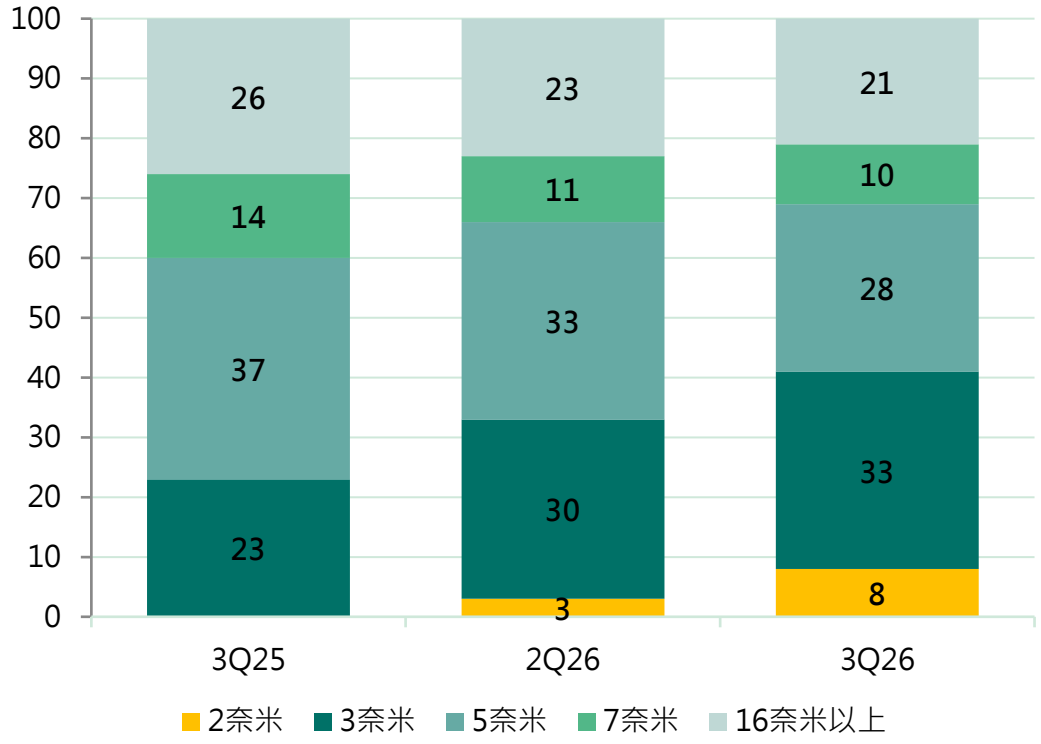


資料來源：台積電、Bloomberg、元大投顧，2026/10/15。

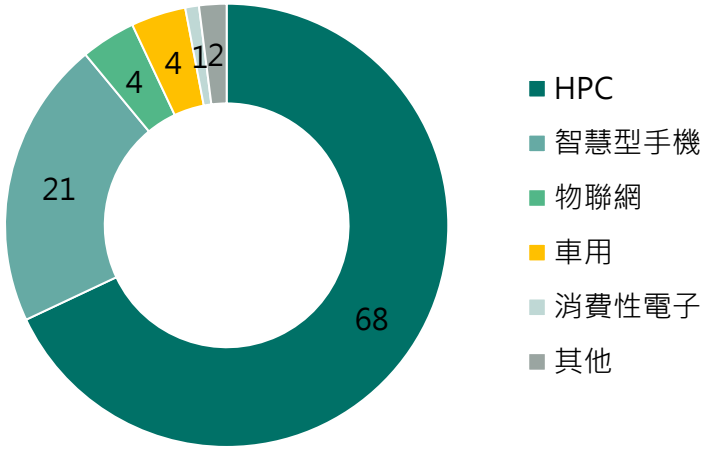
N2 首季貢獻 8%，HPC 營收占比攀升至 68%

- 2 奈米首個完整季度即貢獻 8% 晶圓營收，3 奈米升至 33%；7 奈米以下先進製程合計 79%，較去年同期 74% 持續提升。
- HPC 營收季增 22%，Agentic AI 帶動需求由加速器擴散至 CPU 與網通晶片；車用季增 23%，消費性電子季減 12%。

晶圓營收製程別比重（%）



3Q26 營收平台別（%）



資料來源：台積電 3Q26 Management Report，2026/10/15。註：16奈米以上為 16/20nm 至 0.15μm 以上製程合計。

4Q26 財測優於預期，全年美元營收成長上修至 44%

- 4Q26 營收財測 523–543 億美元，中位數 533 億美元高於前一日彭博共識 503.5 億美元達 5.9%，隱含季增約 14%、年增約 58%。
- 全年美元營收成長由「略高於 40%」上修至約 44%；全年資本支出維持 600–640 億美元。

4Q26 公司財測 vs. 彭博市場共識

項目	公司財測	彭博共識（法說會前一日）	差異
4Q26 營收（美元）	523–543 億 （中位數 533 億）	503.5 億	高於 5.9%
4Q26 毛利率	65%–67%（中位數 66%）	66.1%	-0.1 ppt
4Q26 營業利益率	56.5%–58.5%（中位數 57.5%）	58.0%	-0.5 ppt
2026 營收成長	約 44%	40%以上	上修
2026 資本支出	600–640 億美元	—	維持
匯率假設（美元兌新台幣）	31.8	—	—

毛利率財測略低於共識，主因 N2 擴產與海外廠稀釋：2026 年海外廠稀釋約 2 個百分點，未來數年將擴大至 3–4 個百分點。

資料來源：Bloomberg、台積電、凱基投顧，2026/10/15。

法說會解碼：市場預期 vs. 管理層回應

- **法說前市場預期已提高至最樂觀等級；管理層強調 AI 需求「極為強勁」，營收成長的限制在於供給、而非需求。**

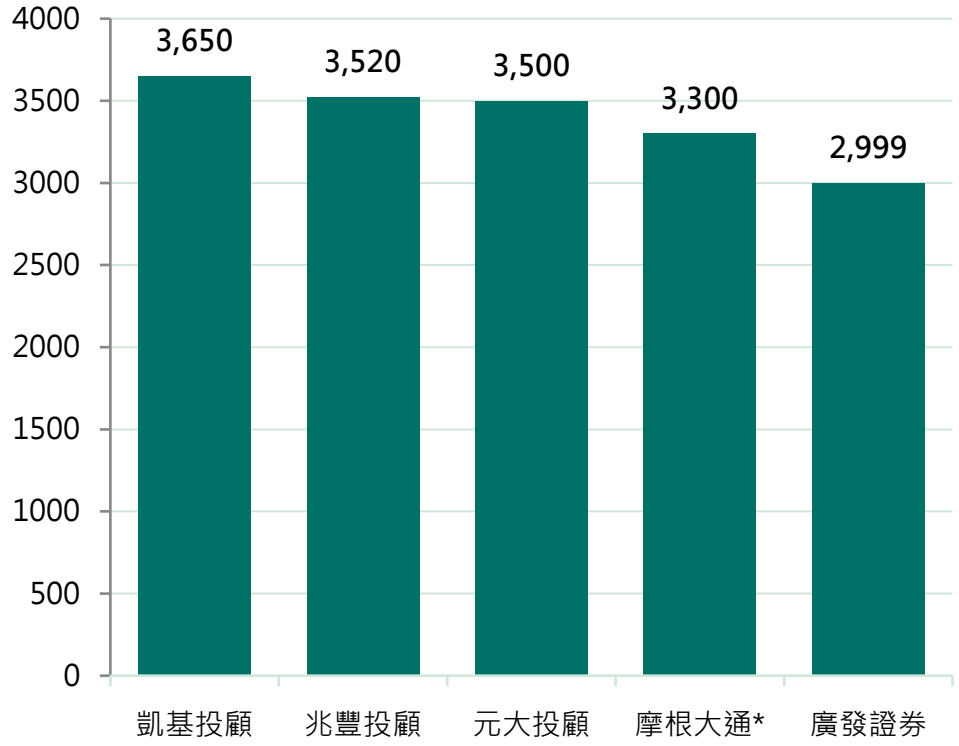
核心議題	法說前市場預期	法說會管理層回應
AI 長期需求	上修 AI 加速器需求	AI 需求未見放緩，供給才是營收瓶頸；Agentic AI 擴大 CPU、網通晶片需求
N3 / N2 產能	確認客戶追單	台南再追加一座 N3 廠（1H28 量產）、亞利桑那 N3 提前至 3Q27；N2 產能 2027 年增逾一倍
資本支出	2026 年突破 600–640 億美元，2027 年上看 700–800 億	2026 年維持 600–640 億美元；未給 2027 年數字，2026–2028 年合計估近 2,500 億美元
先進封裝	CoWoS 擴產速度	CoWoS 吃緊延續至 2027 年；客戶產品順利推出為首要，不排斥封裝備援
美國擴產	德州設廠 / Terafab 合作	評估德州，但尚未做最終決定；與 Terafab 合作前提為台積電主導營運
A14 製程	時程是否提前	2027 年試產、2028 年量產，產能準備已啟動

資料來源：群益投顧、Bloomberg、凱基投顧、元大投顧，2026/10/15。

法說後法人一致看多，目標價上看 3,650 元

- 法說後本土法人維持買進並上調目標價，平均潛在漲幅逾 40%；以 2027 年 EPS 計算本益比約 15–16 倍，位於過去五年 11–32 倍區間下緣。
- 廣發證券則因毛利率略低於預期，維持中立評等、目標價 2,999 元。

法說後目標價（元）vs. 10/15 收盤價 2,440 元



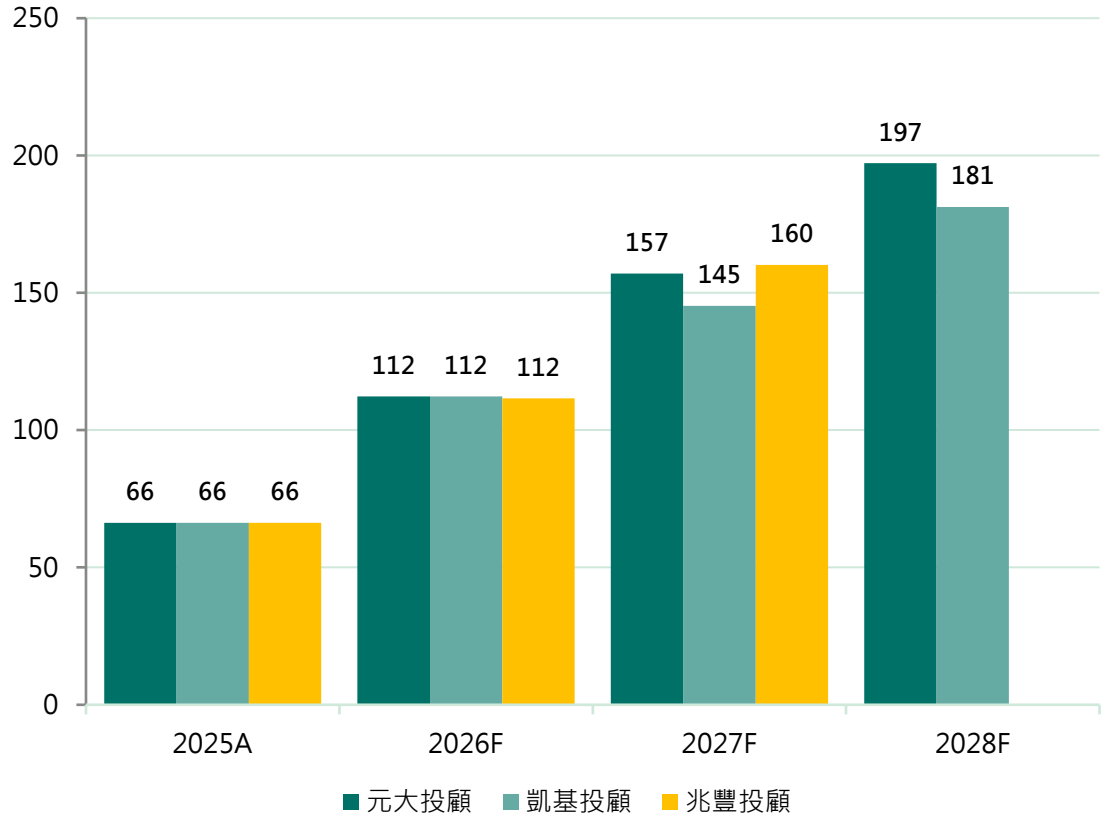
機構	評等	目標價	潛在漲幅
凱基投顧	增加持股	3,200→3,650	49.6%
兆豐投顧	買進	3,000→3,520	44.3%
元大投顧	買進（首選）	3,500	43.4%
摩根大通*	優於大盤	3,300	35.2%
廣發證券	中立	2,999	22.9%
Barclays	優於大盤	ADR 665 美元	—
Freedom Broker	買進	ADR 560 美元	約 30%

資料來源：凱基、兆豐、元大投顧、J.P. Morgan、Bloomberg，2026/10/16。註：*摩根大通為 10/8 法說前報告；潛在漲幅以 10/15 收盤價 2,440 元計算

獲利動能延續：2027 年 EPS 預估挑戰 145–160 元

- 法人預估 2026 年 EPS 約 112 元（年增約 69%），2027 年再成長 30%–43%；元大預估 2027/2028 年毛利率可望達 69%/72%，主因 2027 年先進製程報價調漲 5%–10%。

各機構 EPS 預估（元）



評價指標	2026F	2027F	2028F
EPS（元大）	112.23	157.06	197.19
本益比（倍）	21.7	15.5	12.4
毛利率（元大）	66.8%	69.2%	71.5%
ROE（元大）	37.4%	36.6%	33.1%
現金股利（元）	28.0	32.0	36.0

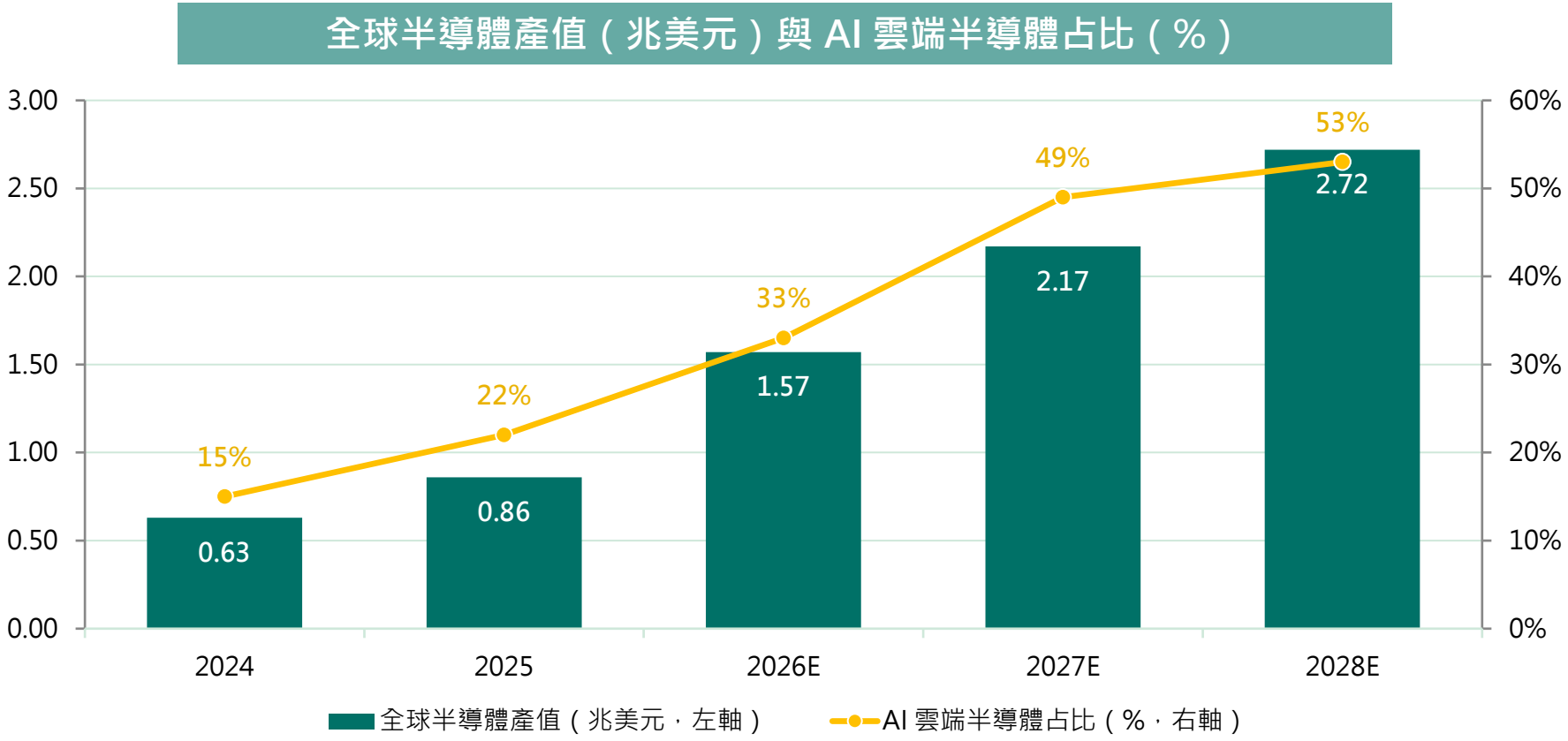
彭博共識：2026 年 EPS 109.28 元；4Q26 EPS 32.09 元。

資料來源：元大投顧、凱基投顧、兆豐投顧、Bloomberg，2026/10/15–16。註：本益比以 10/15 收盤價 2,440 元計算。

二、先進製程擴產，迎AI超級週期

AI 推動全球半導體產值邁向 2 兆美元

- 本輪上行週期由資本密集的 AI 基礎建設驅動，不同於過往的消費換機循環；AI 雲端半導體占產業營收比重預估由 2024 年約 15% 升至 2027 年 49%。
- 記憶體 2026 年預估年增約 250%、規模逾 8,000 億美元；邏輯晶片年增約 37%，資料中心半導體年增 56%。

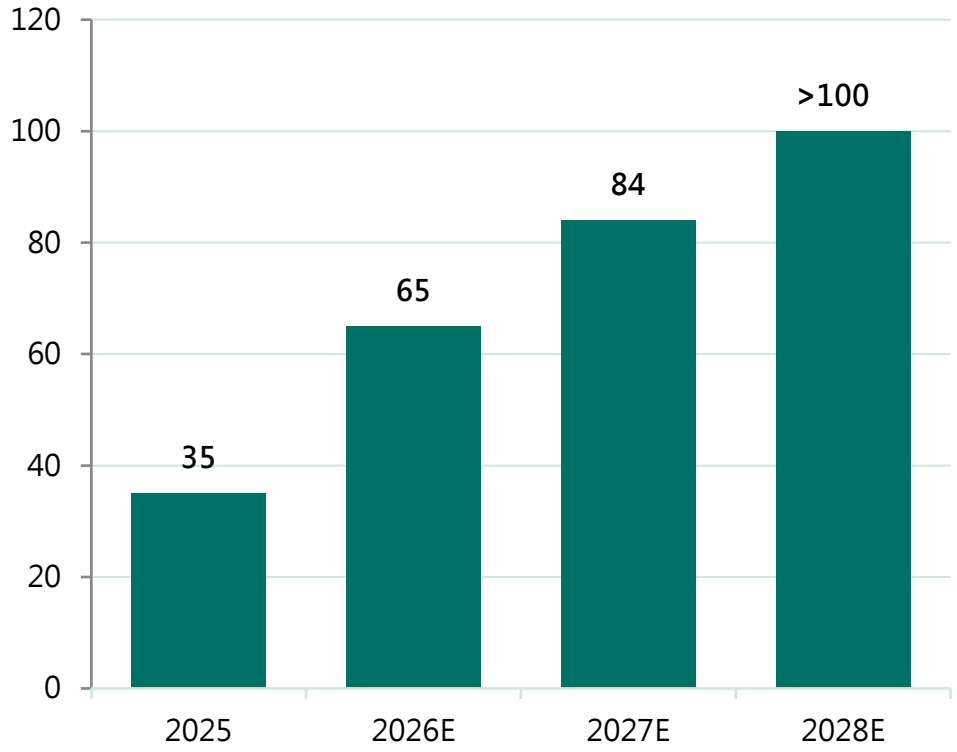


資料來源：Bloomberg，2026/10/15。註：2026E、2027E 產值為預估區間（1.5–1.63、1.9–2.43 兆美元）之中位數。

AI 晶片子市場全面擴張：HBM、ASIC 與設備同步成長

- 超大型雲端業者資本支出預估 2026 年 7,100 億美元、2027 年 9,100 億美元；GPU 與 AI ASIC 合計市場 2026 年成長約 50%，達約 1,650 億美元。
- ASIC 單位運算成本較 GPU 低逾 50%，2025–2027 年複合成長率達 52%，預估 2028 年出貨量超越 GPU。

HBM 市場規模（十億美元）



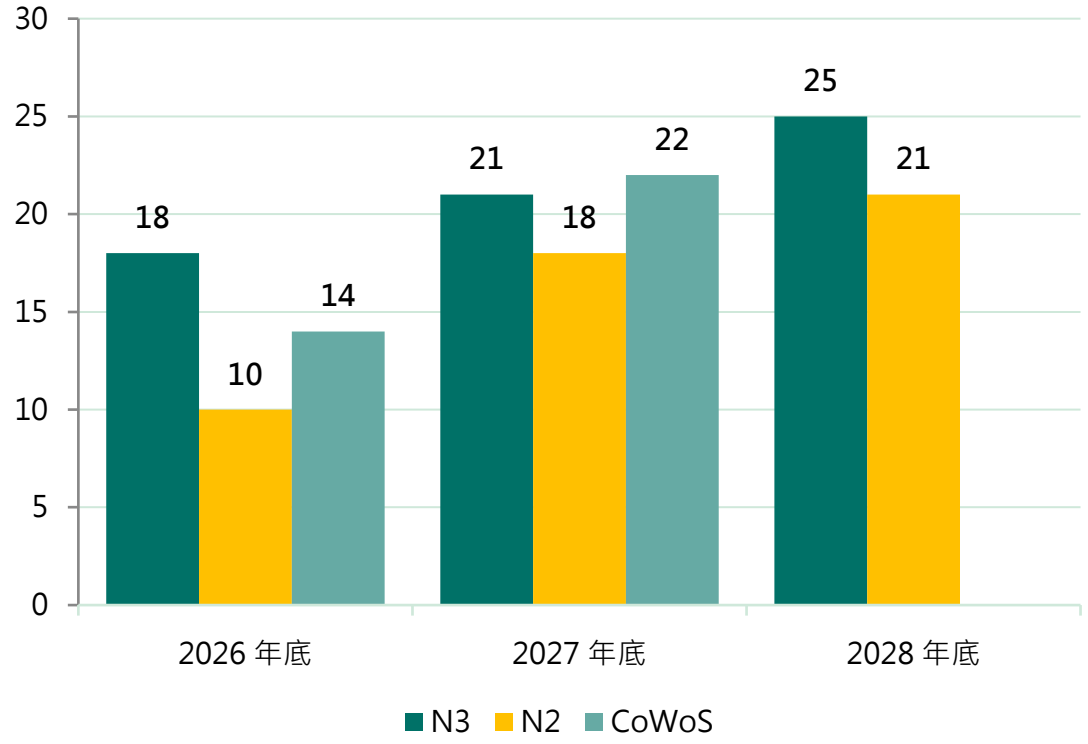
子市場	最新預估
AI ASIC	2024 年 100 億 → 2028 年 740 億美元
GPU + AI ASIC	2026 年約 1,650 億美元（+50%）
晶圓廠設備（WFE）	2026 年 1,430–1,500 億美元（+23%），2028 年 1,900–2,200 億
AI 半導體營收	2027 年約 1,150 億、2028 年 2,300 億美元
台積電先進封裝	CoWoS + SoIC 2027 年營收可望逾 200 億美元

資料來源：Bloomberg，2026/10。註：HBM 2028E 為「逾 1,000 億美元」，以 100 表示。

先進製程與封裝產能加速擴張，供給仍追不上需求

- 台積電鮮少將單一製程擴充至原規劃以上，本次再追加台南 N3 廠，N3 月產能未來兩年將再增約 50%；CoWoS 2026/2027 年底月產能估年增 100%/57%。
- N3 擴產反映三大需求：Agentic AI 帶動的 CPU、HBM4e 客製化基底晶粒、AI ASIC。

台積電先進製程 / 封裝月產能預估（萬片）

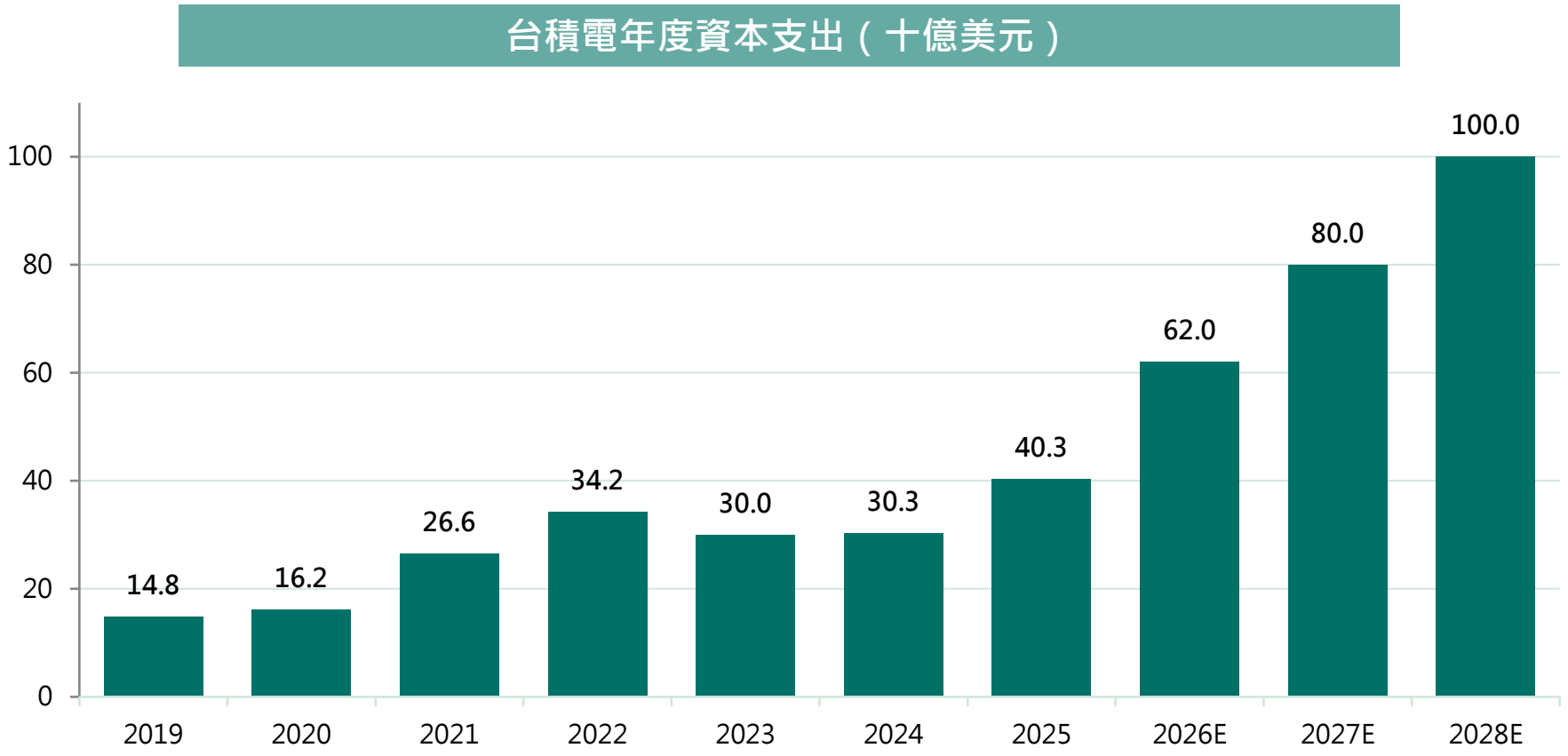


時程	製程 / 產能里程碑
2H26	A16（晶背供電）量產
1H27	台南新增 N3 產線量產
3Q27	亞利桑那 N3 二廠量產（提前）
2027	A14 試產；N2 產能增逾一倍
1H28	台南再追加 N3 晶圓廠量產
2028	A14 量產；日本熊本 N3 量產

資料來源：元大投顧、J.P. Morgan、凱基投顧，2026/10/15。註：N2 2028 年底為 J.P. Morgan 預估；CoWoS 2028 年尚無預估。

資本支出進入前所未見的擴張週期

- 2026–2028 年資本支出合計估近 2,500 億美元，明顯高於過去三年合計約 1,011 億美元；約 70%–80% 投入先進製程，10%–20% 用於先進封裝、測試與光罩。
- 每一美元資本支出將同步帶動設備、廠務工程、材料與封測供應鏈訂單成長。

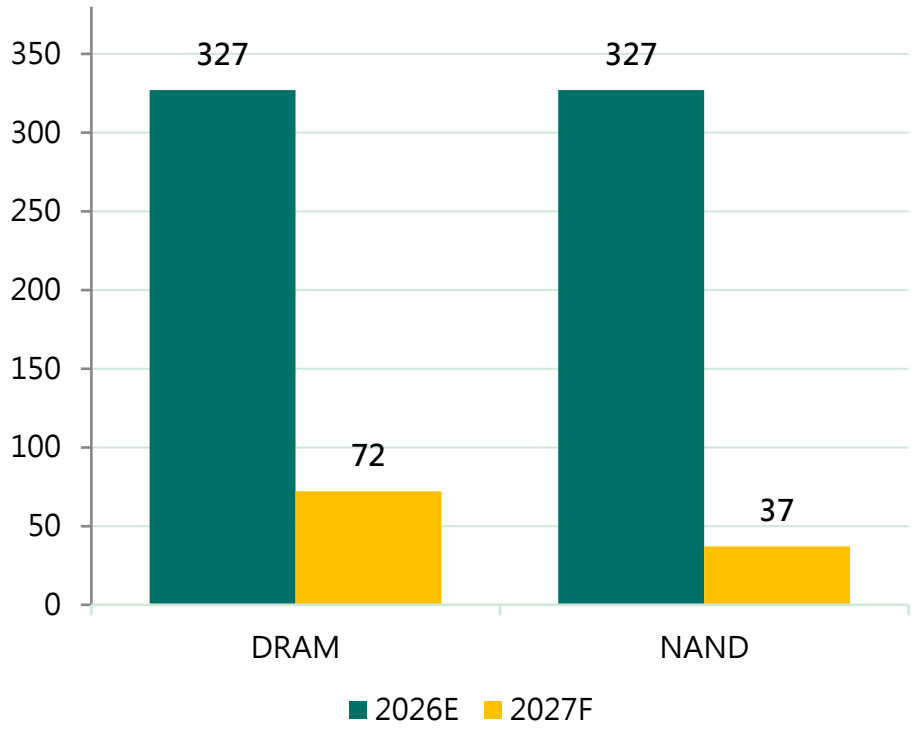


資料來源：元大投顧、J.P. Morgan，2026/10/16。註：2026E 為公司指引 600–640 億美元之中位數；2027E/2028E 為元大投顧預估。

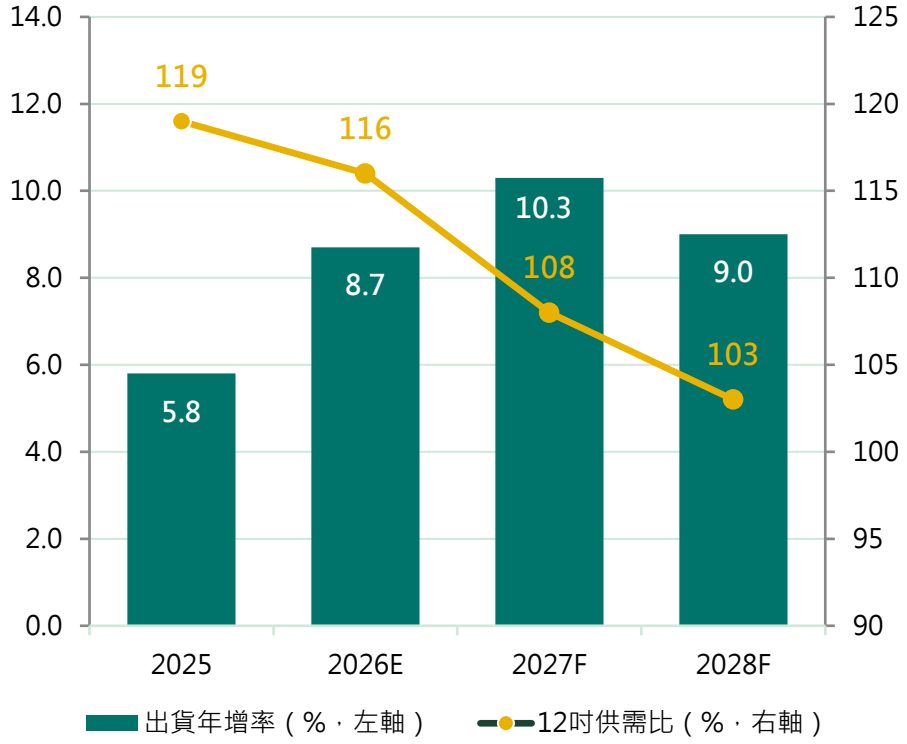
AI 需求外溢至記憶體與矽晶圓，2027 年景氣續揚

- 全球九大 CSP 資本支出 2027 年預估年增 50%；2027 年 DRAM 產值預估年增 72%，三大原廠資本支出年增 38%。
- 矽晶圓五大廠資本支出處低檔，12 吋供需比由 2026 年 116% 降至 2028 年 103%，供需加速改善、漲價效益可期。

記憶體產值年增率（%）



全球矽晶圓出貨年增率（%）



資料來源：TrendForce、SEMI、元富投顧，2026/10/16。

三、台灣掛牌之相關半導體ETF一覽

台灣掛牌之相關半導體 ETF 概覽

半導體是台灣經濟發展的核心產業，從 IC 設計、晶圓製造、封裝測試到設備材料，已形成完整而緊密的產業聚落。隨著 AI 需求從晶片擴散到整條供應鏈，台灣半導體產業可望持續受惠。想參與這波成長，相關半導體 ETF 是方便的工具，一次布局台積電和半導體供應鏈的優質企業，也能分散持有單一個股的風險。

台灣掛牌之相關半導體ETF (投資地區 : 台灣)

	商品代號	商品名稱	規模(億)	含積量(%)	受益人數	三月報酬率(%)	六月報酬率(%)	一年報酬率(%)	兩年報酬率(%)	今年以來報酬率(%)
1	00891	中信關鍵半導體	676	39.9	196437	3.2	36.4	113.8	142.5	97.8
2	00947	台新臺灣IC設計	125	--	38239	0.6	42.2	136.9	163.6	96.0
3	00913	兆豐台灣晶圓製造	28	20.7	13062	-4.0	41.1	127.9	165.6	110.3
4	00892	富邦台灣半導體	129	24.4	47248	0.2	25.7	112.1	147.3	96.4
5	00904	台新臺灣半導體30	81	39.2	24546	-1.9	32.6	114.0	152.0	86.6
6	00927	群益半導體收益	727	14.0	147270	-4.0	51.1	112.6	139.5	93.6

資料來源：CMoney，2026/10/16。註：以上ETF篩選投資地點為台灣且名稱中含有半導體、IC、晶圓的相關ETF。

相關ETF介紹(一) 00891 中信關鍵半導體

00891 中信關鍵半導體 是一檔高度聚焦台灣半導體產業的主題型ETF，追蹤「NYSE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，掌握AI、高效能運算及先進製程等長期成長趨勢，提供投資人一站式參與台灣關鍵半導體供應鏈成長契機。



資料來源：CMoney，2026/10/16。

相關ETF介紹(二) 00927 群益半導體收益

00927 群益半導體收益 聚焦台灣半導體產業，透過兼顧市值與收益特性的選股機制，結合半導體產業成長動能與收益訴求，提供投資人參與產業長期趨勢並兼顧現金流需求的布局工具。



資料來源：CMoney，2026/10/16。

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】
本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。
中國信託證券投資顧問股份有限公司
台北市南港區經貿二路188號5樓及18樓 / (02) 5569-1988
營業執照字號：114金管投顧新字第014號